

Call for Papers

ADMETA^{Plus} 2013

Advanced Metallization Conference 2013: 23rd Asian Session

2013年10月7日(月)～10日(木) 東京大学 弥生講堂・一条ホール (本郷)

主催 : 公益社団法人 応用物理学会

協賛 (予定) : 表面技術協会, 電気学会, 精密工学会, 電子情報通信学会, 日本金属学会,
IEEE EDS Japan Chapter, 日本真空協会, 日本表面科学会

2013年10月に“Advanced Metallization Conference 2013: 23rd Asian Session”(ADMETA^{Plus} 2013)が開催されます。本会議は ULSI に用いる最先端配線技術の会議として 25 年以上の実績を有しており, 1989 年からは日本を中心としたアジアでの著しい技術進展を鑑み, 米国と日本で毎年ほぼ同時期に開催しております。

今日では最小線幅 50nm 以下を目指した Cu 多層配線技術が活発に開発・実用化されており, Flash, DRAM 等のメモリーへと応用範囲も広がっています。しかし Low-k/Cu 配線では, エレクトロマイグレーションや Low-k 膜の信頼性確保が依然として重要な課題であります。また, シリサイドやメタルゲートなど, トランジスタ周りでも新材料の導入が進められております。実装技術の微細化も急ピッチで進みつつある中で, Si チップと実装基板を含むシステムとしての統合的な配線技術の概念が求められています。中でも, 三次元配線技術は, これからの方向性の一つとして注目されています。

これらの分野において, 材料技術, 配線設計, 信頼性, 装置, コスト等の観点で解決すべき課題は山積みです。本会議では, 今後の電子デバイスの高性能化・高集積化にとってキーとなる配線技術を中心とした課題にフォーカスし, これらの課題の解決に向けて基礎から応用まで研究開発上のトピックスについて議論を行います。

更に本年のセッションでは, 従来形式の講演に加えて, 4つの分野 (Backend Device Technologies, Nanocarbon, 3D Challenges, CMP) においてオーガナイズドセッションを設け, より魅力的なプログラム構成を目指しております。

本会議を通して, 配線技術とその関連分野の発展に寄与していきたいと考えております。

ADMETA^{Plus} 2013 委員長 小池 淳一 (東北大学)

ADMETA^{Plus} 2013 論文委員長 伊藤 文則 (ルネサスエレクトロニクス)

Session Categories

Conference Topics of Interest

Integration : 多層配線構造, 配線性能 (RC Delay), 配線抵抗, 配線間容量, 信頼性関連技術, 評価・解析技術 など

Reliability Science and Failure Analysis : EM, SIV, TDDB, 評価技術, 欠陥検査, 歩留・ばらつきのモデリング など

Metallization : 成膜方法 (PVD, CVD, ALD, めっき 他), バリアメタル, シード, 合金, 超臨界, リフロー など

Low-k Dielectric : 成膜方法 (CVD, ALD, SOD 他), 膜特性, 界面特性, 新規材料・構造 (Air gap 他), 評価技術 など

Contact : シリサイド, 形成プロセス, 界面, 固相反応, 浅接合, 結晶物性, 電子物性, キャリア輸送, 寄生抵抗など

3D : COW, WOW, 薄化, 積層, 接着材, TSV (エッチング, CVD, PVD, めっき, CMP 他), TMV, バンプ, 個片化, 再配線, 冷却, 信頼性 など

MEMS/RF : 配線構造, 配線材料, パッケージング, 薄膜形成技術, エッチング技術, 洗浄, CMP, めっき, 立体加工技術, スイッチ, インダクタ, バラクタ, 共振子, 伝送線路 など

Emerging Technology : アクティブ配線, エレクトロルミネッセンス, シリコンフォトニクス, パワーエレクトロニクス, フレキシブルエレクトロニクス, エネルギーハーベスティング など

Organized-Session Topics of Interest

Backend Devices Session : 多層配線内デバイス混載技術 (MRAM, PCRAM, ReRAM 他), 電極技術, 磁性・相変化・抵抗変化材料, プロセス技術 など

CMP Session : 平坦化加工, スラリー, パッド, ドレス, 終点検出, 洗浄技術, 防食技術 など

Nanocarbon Interconnects Session : グラフェン, カーボンナノチューブ, 成膜・成長技術, インテグレーション, 電気特性, 信頼性, 評価・解析技術, ドーピング など

Conference Keynote 講演者

1) Atsuyoshi Koike (SanDisk Limited)

2) Shinichiro Kimura (LEAP)

Conference 招待講演者

- 1) Meike.Hauschildt (GLOBALFOUNDRIES) [Crucial Metal Technologies]
- 2) Yukihiro Shimogaki (The Univ. of Tokyo) [Advanced Metal Processes]
- 3) Shoji Kamiya (Nagoya Inst. of Tech.) [Advanced Metal Processes]
- 4) Fen Chen (IBM) [Reliability and Contacts]
- 5) Nobuyoshi Kobayashi (ASM Japan) [Low-k]
- 6) Xiao Hu Liu (IBM) [Low-k]

Organized Session 招待講演者

- 1) Tadatomo Suga (The Univ. of Tokyo) [3D Challenge]
- 2) Tzu Kun Ku (ITRI) [3D Challenge]
- 3) Tadashi Sakai (LEAP) [Nanocarbon]
- 4) Kaustav Banerjee (UCSB) [Nanocarbon]
- 5) Kumar Virwani (IBM) [Backend devices Technology]
- 6) Koji Tsunoda (LEAP.) [Backend devices Technology]
- 7) Cheol Seong Hwang (Seoul National Univ.) [Backend devices Technology]
- 8) Toshiji Taiji (Renesas Electronics) [CMP]
- 9) Jam Sorooshian (Intel) [CMP]

Tutorial 講演 (5) を除いて日本語にて行います

- 1) 「Cu-Low K インテグレーション技術の現状と将来動向」 福山 俊一 (富士通)
- 2) 「半導体デバイス製造における無電解メッキ/選択エッチングについて」 川島 敏 (メルテックス)
- 3) 「SiC デバイスおよびプロセスの最新動向」 矢野 裕司 (奈良先端科学技術大学院大学)
- 4) 「半導体製造装置の市場動向」 和田木 哲哉 (野村證券)
- 5) 3D (TSV) Sunil Wickramanayaka (Institute of Microelectronics)
- 6) 「いまさら聞けない CVD」 河瀬 元明 (京都大学)
- 7) 「イメージセンサにおけるオンチップ光学系」 寺西 信一 (パナソニック)
- 8) 「半導体製造プロセス用 CMP の極意」 辻村 学 (荏原製作所)

★ 会 期 : Tutorial — 2013年10月7日(月)

Conference — 2013年10月8日(火)~10日(木)

★ 会 場 : 東京大学 弥生講堂・一条ホール (本郷キャンパス) <http://www.a.u-tokyo.ac.jp/yayoi/>

★ 講演概要

・使用言語: 英語、講演形態: Oral [発表 15分+質疑応答 5分 (予定)] もしくは Poster

★ 応募要項: 投稿を下記の要領で作成し, ADMETA^{Plus}2013 事務局までご送付ください。

- 1) 英文 Abstract: A4 フォーマット, 本文 (1枚) + 図面 (1枚) の計 2 ページ, 枚数厳守, フォントは「10 ポイント Times New Roman」。1 枚目の本文の最初に, 論文タイトル, 著者, 所属, 住所, E-mail を記載してください。投稿用フォーマット等の詳細は, 下記ホームページを参照してください。
- 2) 希望セッション: 発表希望セッションを前頁の「Session Categories」より選択してください。
- 3) 送付方法: 英文 Abstract (PDF ファイル) 及び希望セッションを, 電子メールにてお送りください。
- 4) 投稿締切: ~~2013年6月21日(金)~~ >> 2013年7月5日(金) **投稿締切が延長されました。**
- 5) 投稿いただきました Abstract は, Conference 当日配布予定の CD-ROM 予稿集といたします (参加登録者には, 10月1日に Web からの事前ダウンロードも可能とします)。なお, 印刷物をご希望の方には予約販売を予定しています。
- 6) 採択通知: 8月1日までに著者へ連絡の予定です。
- 7) US Session へ Asia 地区から投稿する場合には, Asian Session へも同一内容の投稿を願います。この場合 Abstract は, US および下記 Asian 事務局の両方へ送付願います。(なお, 今年の US Session については下記参照。)
- 8) 採択論文につきましては, Japanese Journal of Applied Physics (JJAP) の ADMETA^{Plus} 2013 特集号として 2014年4月に発行される予定です。希望者は, 本会議開催後 11月10日までに Proceeding 原稿を提出していただきます。論文作成につきましては, Regular Paper または Brief Note のいずれかを選択できます。但し, US Session のプロシーディング (AMC Proceedings) は別に発行予定ですので, US/Asian Session の両方で採択された場合, AMC Proceedings か JJAP 特集号のいずれかを選択し, AMC Proceedings の場合は US Session へ, JJAP 特集号の場合は ADMETA^{Plus} 2013 事務局へ原稿を提出ください。両方へ同じ論文を投稿すると二重投稿となる可能性があります (Abstract は US/Asian で同じで構いません)。

※ ご注意: Extended Abstracts に掲載される論文は原著論文になりますので, 多重投稿とならないようにご注意ください。

★ 論文投稿・問合せ:

ADMETA^{Plus} 2013 事務局 担当 吉田 連絡先

〒113-8656 東京都文京区本郷 4-1-7 近江屋第二ビル 502 号室 (株)リアライズ理工センター内

TEL: 03-6801-5685, FAX: 03-6801-5686, E-mail: jimukyoku@admeta.org



Asian Session: <http://www.admeta.org/>

- Tutorial: October 7, 2013

- Conference: October 8–10, 2013

U.S. Session: <http://www.advancedmetallizationconference.com/>

- Conference: October 21-23, 2013, CNSE, Albany, New York